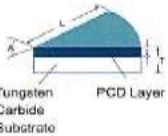

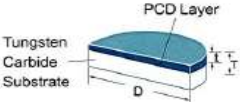

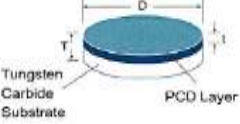

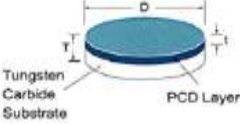

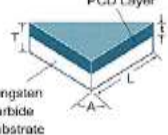

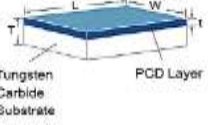




TABELA PCD

Desenho	Produto No	Ângulo (A)	Diâmetro(D)	Espessura(T)	Imagem
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	R90/6.5	90	6.5	1.6/2.0/3.2	
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	R180/8.0	180	8.0	1.6/2.0/3.2	
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	R360/58	360	58	1.6/2.0/3.2	
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	R360/6.0	360	6.0	1.6/2.0/3.2	
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	T35/7.0	35	7.0	1.6/2.0/3.2	
 <p>Tungsten Carbide Substrate PCD Layer</p>	L5.0/4.0	5.0	4.0	1.6/2.0/3.2	
	TT2 - Special			1.6/2.0/3.2	



Característica do PCD

Grão/ Tamanho (μm)	Grade	Aplicação	Característica
2 μm	CT 002	Ligas de Alumínio com baixo teor de silício.	Excelente acabamento superficial e Excelente Resistência.
5 μm	GC 005	Ligas de cobre, Ligas de alumínio com baixo teor de silício, Madeira e Bambu.	Acabamento de Superfície muito bom e boa resistência
10 μm	GC 010	Objetivo Geral - <14% de ligas de Si / Al e ligas de cobre - Bom desaste - Composto de Madeira	Bom desgaste e Bom acabamento de superfície.
	GD 010	- Composto de Madeira, Plástico e Composto de Plástico.	Desgaste Resistência Geral e Boa Condutividade.



PCD - GRADE DISPONÍVEL

Tamanho Médio do (micron)	Grade
2 μm	CT 002
5 μm	GC 005
10 μm	CG 010
	GD 010
25 μm	GA 025
	GD 025
3+25 μm	GM 253